

## AIROC™ CYW20835 Bluetooth® LE SoC

AIROC™ CYW20835 Bluetooth® LE SoCは、IoTアプリケーション向けのBluetooth® 5.2コア仕様に準拠したデバイスです。業界最先端の40nm CMOS低消費電力プロセスを用いて製造されたCYW20835は、高集積化により外付け部品を最小限に抑え、デバイスのフットプリントとBluetooth® Low Energyソリューションの実装に伴うコストを削減します。



### 主な特長

AIROC™ CYW20835 Bluetooth® LE SoCは、ホームオートメーション、アクセサリ、センサー（医療、ホーム、セキュリティ、産業）、照明、Bluetooth® Mesh、ゲームコントローラー、リモコン、キーボード、ジョイスティックなどのワイヤレス入力デバイス、またはBluetooth® LEで接続されたIoTアプリケーションなど、Bluetooth® Low Energyのユースケースにすべて対応するように設計されています。

### 主な利点

インフィニオンのAIROC™ CYW20835 Bluetooth® LEモジュールは、オンボードの水晶振動子、受動部品、フラッシュメモリ、CYW20835システムオンチップを完全に集積しています。高集積化されたこれらのモジュールは、グローバルに認証されており、迅速な市場投入をサポートします。AIROC™ CYBLE-343072-02は、ModusToolbox™ソフトウェアのAIROC™ Bluetooth® SDKと、コード例が準備されたツールによってサポートされており、組み込みBluetooth® LEアプリケーションの迅速な開発をサポートします。

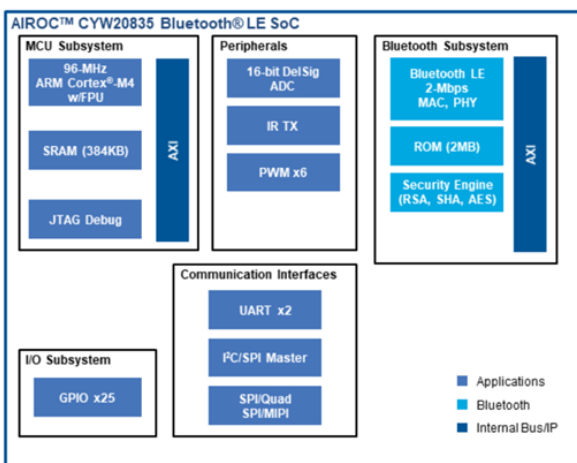
### 対象アプリケーション

- > スマートホーム
- > ファクトリーオートメーション
- > メディカル&ヘルスケア
- > スマートビルディング

### 競合製品に対する優位性

- > 信頼性の高い、長距離通信対応のBluetooth® LEの接続性
- > エッジ処理が可能
- > アナログとデジタルのICをチップセットに統合し、外付け部品との接続が容易
- > インフィニオン、Bluetooth®設計の生産開始に向けた重要なステップを担当

### ブロック図



### 製品関連情報/オンラインサポート

[製品ページ](#)

[製品パンフレット](#)

[ソフトウェア](#)

### 製品概要および製品データシート ページへのリンク

発注可能な部品番号	登録可否	パッケージ
<a href="#">CYBLE-343072-02</a>	Y	SMT43
<a href="#">CYBLE-333074-02</a>	Y	SMT43
<a href="#">CYBLE-343072-EVAL-M2B</a>	-	ボード